

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2025-050

生益电子股份有限公司 关于投资智能制造高多层算力电路板项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 项目名称：智能制造高多层算力电路板项目。
- 投资金额：总投资金额约 19 亿元人民币，其中包括吉安二期项目已投入的厂房建设、设备等费用，本次新增投资约 17.5 亿元人民币。
- 相关风险提示：

1、本项目投资总额较高，且资金来源为公司自有或自筹资金，因此本项目的资金保障可能会受到公司经营情况的影响。

2、本项目实施尚需政府立项核准及报备等审批工作，如因有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化，本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、由于市场本身具有不确定因素，PCB 中高端市场长期需求存在不确定性，如果未来市场需求增长低于预期，或业务推广进度、产品价格波动等与公司预期产生较大偏差，本项目的实施也可能存在变更、延期、中止或终止的风险，同时也有可能存在本项目全部实施后达不到预期效益的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、 本次对外投资概述

（一）基本情况

本项目为基于“吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目”(以下简称“吉安二期项目”)所继续实施的投资。吉安二期项目原为公司首次公开发行股票募投项目，为提高募集资金使用效率，公司根据市场环境的变化、行业发展趋势以

及公司产能布局规划，于 2025 年 3 月 26 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，并于 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过该议案，将原计划使用于吉安二期项目的募集资金全部变更用于“智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期”，该变更不影响吉安二期项目的建设，公司将结合战略规划进一步论证继续推进吉安二期项目的实施。

现结合市场发展趋势，根据公司新一轮战略规划和对内外部需求的充分调研评估，公司董事会于 2025 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第三十次会议审议决议在吉安二期项目现有厂房的部分楼层投资智能制造高多层算力电路板项目（简称“本项目”），本项目计划投资总金额约 19 亿元人民币，包括但不限于公共设施、生产设备、检测设备等相关投入，其中包括吉安二期项目相应楼层已投入的厂房建设、设备等费用。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施该项目。

（二）决策与审批程序

公司于 2025 年 8 月 14 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于投资智能制造高多层算力电路板项目的议案》，同时，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员在本事项内制定与实施具体方案，及办理其他与本事项相关的一切事宜。

上述授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会授权范围之内，无须提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 本次对外投资的基本情况

1、项目名称：智能制造高多层算力电路板项目。

2、实施主体和项目地点：本项目由本公司全资子公司吉安生益电子有限公司实施，项目地点位于江西省吉安市井冈山经济技术开发区。

3、投资金额：总投资金额约 19 亿元人民币，其中包括吉安二期项目相应楼层已投入的厂房建设、设备等费用，本次新增投资约 17.5 亿元人民币。

4、资金来源：自有资金或自筹资金。

5、项目建设期：本项目计划分两阶段实施，总建设周期计划 2.5 年。其中第一阶段预计在 2026 年试生产；第二阶段预计在 2027 年试生产。

6、市场定位及可行性分析：

本项目聚焦智能制造高多层算力电路板领域，旨在满足服务器、高多层网络通信及快速发展的 AI 算力等中高端市场需求。在产能规划上，项目计划年产印制电路板 70 万平方米，每阶段各年产 35 万平方米。项目的推进有利于公司资源整合与产能布局优化，更好地契合市场需求增长态势。从投资价值来看，本项目税后动态回收期为 8.4 年，具有显著的可行性，且将助力公司提升经济效益。

本项目投资总额、预期收益等数据均为预估数值，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

三、 本次对外投资对公司的影响

本项目符合国家相关的产业政策、行业发展趋势，系公司根据公司整体发展规划和战略布局需要所实施的投资行为，有利于进一步扩大公司经营规模，促进公司产业化发展，从而提升公司盈利能力和行业竞争力。本项目不会对公司 2025 年度经营业绩产生重大影响。

四、 本次投资的风险分析及应对措施

1、本项目投资总额较高，且资金来源为自有或自筹资金，因此本项目的资金保障可能会受到公司经营情况的影响。公司近年来现金流稳定，负债率在同业中相对较低，公司将统筹资金安排，以确保项目顺利实施。

2、本项目实施尚需政府立项核准及报备等审批工作，如因有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化，本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。公司将积极与地方政府、有关部门保持有效沟通，做好相关工作，为项目实施提供多方面的支持，全力配合各项审批工作的推进。

3、由于市场本身具有不确定因素，PCB 中高端市场长期需求存在不确定性，如果未来市场需求增长低于预期，或业务推广进度、产品价格波动等与公司预期产生较大偏差，本项目的实施也可能存在变更、延期、中止或终止的风险，同时也有可能存在本项目全部实施后达不到预期效益的风险。公司将密切关注行业上下游动态，以市场需求为导向，积极与客户展开多领域深度合作，努力提升成本效能，提高产品竞争力，以降低市场风险。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日